

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 6 月 23 日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/056684 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C08L 101/00, C08K 3/00, 3/34, H05K 1/03
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018623
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 14 日 (14.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2003-417175  
2003 年 12 月 15 日 (15.12.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 積水化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 4 番 4 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柴山 晃一 (SHIBAYAMA, Koichi) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山 2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 米澤 光治 (YONEZAWA, Koji) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山 2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 宮▼崎▲主税, 外 (MIYAZAKI, Chikara et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町 1 丁目 6 番 5 号 西村ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書  
— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION, MATERIAL FOR SUBSTRATE AND FILM FOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 熱可塑性樹脂組成物、基板用材料及び基板用フィルム

(57) Abstract: Disclosed is a thermoplastic resin composition which enables to obtain a molded article that is capable of maintaining the molded shape even when the article is heated after molding and is excellent in dimensional stability and heat resistance. The thermoplastic resin composition contains 100 parts by weight of a thermoplastic resin and 0.1-100 parts by weight of an inorganic compound dispersed in the thermoplastic resin. Not less than 75% of the molded shape of an article can be maintained even after the article is heated to a temperature not less than the glass transition temperature or melting point of the thermoplastic resin. Also disclosed are a material and a film for substrates composed by using such a thermoplastic resin composition.

(57) 要約: 賦型された形状を、賦型後に加熱された場合でも保持することができ、寸法安定性及び耐熱性に優れた成形品を得ることを可能とする熱可塑性樹脂組成物を得る。熱可塑性樹脂 100 重量部と、熱可塑性樹脂に分散された無機化合物 0.1 ~ 100 重量部とを含み、賦型された形状が、熱可塑性樹脂のガラス転移温度または融点以上に加熱された後でも 75% 以上保持される熱可塑性樹脂組成物、並びに該熱可塑性樹脂組成物を用いて構成された基板用材料及びフィルム。

WO 2005/056684 A1